

附件：IC 新創落地輔導資源需求表

辦法說明：

藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創在台落地實現潛力產品。

詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)

產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：

產品規格：(請條列細節)

產品開發之資源需求：(可複選並說明)

EDA tool 需求：_____

IP 需求：_____

IC 設計服務需求：_____

規劃投片晶圓廠：_____

製程節點：____ nm

製程類型 type (GP, BCD, RF, Mixed-Signal...etc.) : _____

封測需求：_____

系統整合需求：_____

設備製造商:

產品開發之時程規劃：

已接洽過之臺灣廠商：

其他需求說明：(可複選並說明)

- 商務發展需求：_____
- 募資需求：_____
- 在台設立公司：_____
- 其他（可條列說明，如產品開發需求之額外補充....等）：_____

股權資料內容

股權結構：

股東名稱	國籍	持股比例

簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；未成立公司之團隊則需所有團隊成員
簽署)：_____